

Durastack基板対基板用コネクタ

デバイスエンジニアは、PCB実装面積を削減し、簡素化によって製造性が向上するコネクタを必要としています。DuraStack基板対基板用コネクタは、インサート成形のアーマーネイルと内部カバーを備えており、基板の保持力と強度を高め、幅広いアライメントを実現します。これにより、組み立てとメンテナンスが簡素化され、デバイスエンジニアは、信頼性を損なうことなく、より少ないスペースでより多くの設計を行うことができます。

利点と特徴

カスタマイズの可能性を広げる

コネクタの幅広いピンオプションは、多様な設計要件を満たすのに役立ち、さまざまなアプリケーションで柔軟な統合を可能にします。

歩留まり率の向上

インサート成形の内部カバーは、アーマーネイルの強度を高め、組み立て中の損傷を防ぎます。

省スペース化を実現

小型フォームファクターは、コネクタのフットプリントとピッチを最小化することでデバイスの小型化を可能にし、PCBの実装面積を拡大します。

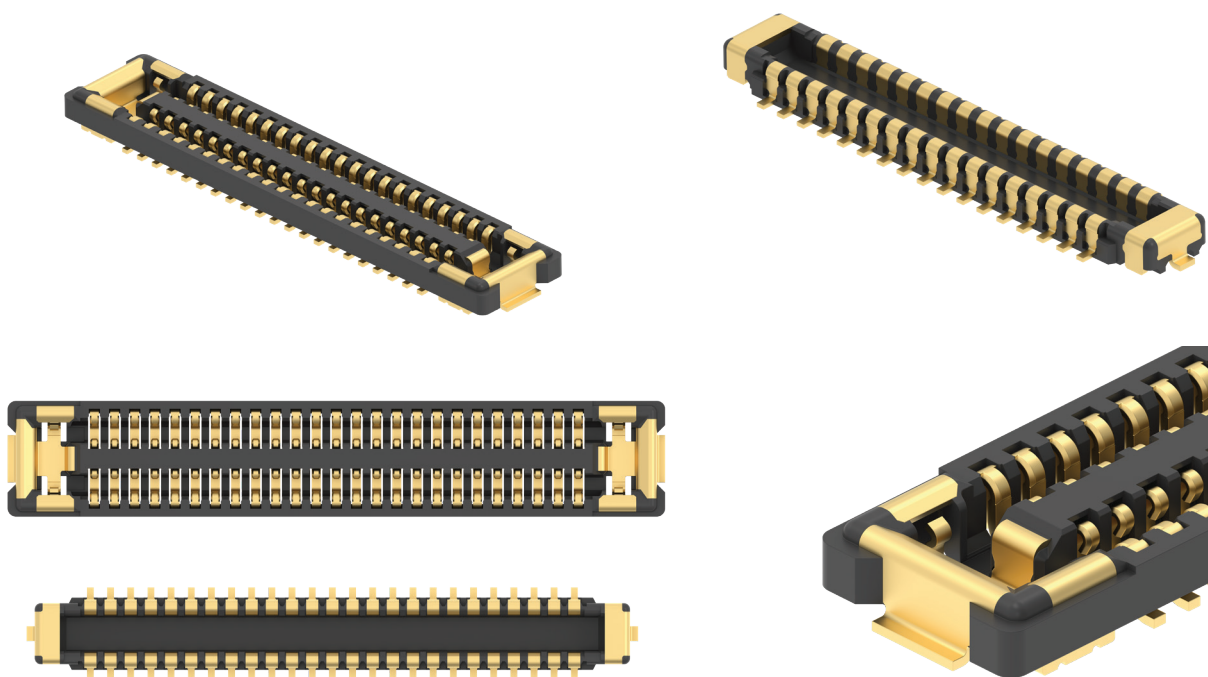
高さ	0.80mm	
回路数	42、50および60	
ピッチ	0.35mm	
電圧	50V	
電流(最大)	信号	0.3A
	パワー	5A

信頼性の向上

インサート成形アーマーネイルはPCBの保持力を高め、衝撃や振動を受けるデバイス内での動きに抵抗するのに役立ちます。

製造効率と製品品質を向上

幅広いアライメントにより誤嵌合を防ぎ、ダウンタイムと生産コストを削減します。



上面図

インサート成形アーマーネイル

Durastack基板対基板用コネクタ

市場およびアプリケーション

家電

冷蔵庫
スマートホームデバイス
テレビ
洗濯機

オートモーティブ

先進運転支援システム
エンジン制御ユニット
インフォテインメントシステム

産業オートメーション

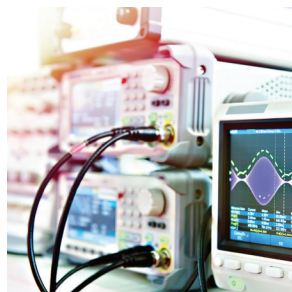
ファクトリーオートメーション機器
ロボティクスアーム

医療技術

診断機器
患者モニタリングデバイス

モバイルデバイス

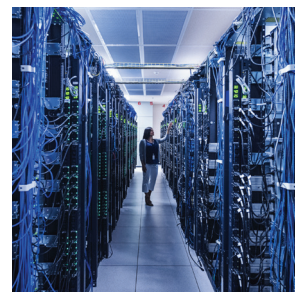
PC
ポータブルコンピューティングデバイス
スマートフォン



テスト・計測システム



患者モニタリングおよび
イメージング機器



ハブおよびサーバー

ネットワーク

ルーター
スイッチ
ワイヤレスアクセスポイント

ウェアラブル

フィットネストラッカー

仕様

参考情報

梱包：リール巻きエンボステープ。
設計仕様：ミリメートル
RoHS：あり
ハロゲンフリー：低ハロゲン

電氣的仕様

電圧（最大）：50V
電流（最大）：
信号コンタクト—0.3A
パワーネイル—5.0A
接触抵抗（最大値）：
シグナルコンタクト—30ミリオーム
電源コンタクト—15ミリオーム
絶縁抵抗（最小）：100メガオーム
絶縁耐電圧：250V AC

機械的

ピッチ：0.35mm
嵌合高さ（213184および213185シリーズ）
：0.80mm
幅：2.00mm
長さ：{(回路/2-1) x ピッチ} + 3.02mm
回路サイズ（213184および213185シリーズ）：
42~60ピン
耐久性（最大）：30回
アライメント：0.40mm（ピッチ）および0.35mm
（スパン）

機械的

ハウジング：LCP、UL94V-0、黒色
接点：銅合金
メッキ：
コンタクト面—金
はんだテール面—金
下地メッキ—ニッケル
挿入力（最大）：
初期—52.5N
30回後—75N
引抜き力（最小）：
初期—7.49N
30回後—10.7N
温度上昇（最大）：30°C
動作温度：-40~+85°C